

2023학년도 후기 명지대학교 대학원 반도체장비공학과 석사과정 신입생 모집

| 중소기업 계약학과(재교육형) 정원 20명 등록금 최대 65% 정부지원

모집단위 및 특전

모집학과	모집과정	모집정원
 명지대학교 대학원 「반도체장비공학과」	 석사과정 (재교육형)	 20명

지원자격 및 입학조건

○ 특전: 공학석사 학위수여, 졸업 후 박사과정 응시가능, 성적우수자 장학금 지원

- 

기업

 - 중소기업 및 중견기업
 - 단 부동산업, 유흥주점업, 기타 주점업, 게임업 및 배팅업, 무도장 운영업을 영위하는 기업은 제외
- 

학생

 - 중소·중견기업 재직근로자
 - 학위과정의 교육내용과 소속기업의 업종 또는 수행하고 있는 직무와 상호 관련이 있는 근로자
 - 학사학위 또는 이와 동등 이상의 학력 소지자
- 

입학조건

 - 6개월 이상 재직 중인 근로자가 졸업 후 1년 이상 근무하는 조건

혜택안내

구 분	내 용
기업	- 참여 우수기업 포상 및 해외연수 기회 제공 - 기업의 핵심인력 양성 및 장기재직 유도
학생	- 교육비 혜택(정부지원 65%)지원 - 다음의 경우 정부지원금 추가 지원 - 내일채움공제(청년내일채움공제 포함) 가입 근로자 (10%) - 중소기업 기술개발지원사업 성공과제 참여 근로자 (5%)

학사관리

- **졸업 요건**: 4학기 등록, 24학점 이수, 외국어 및 종합시험 합격, 학위청구 논문(프로젝트 보고서 대체 가능)
- **강의 시간**: 평일 야간 및 토요일
- **강의 장소**: 명지대학교 용인캠퍼스

전형일정

- 

원서접수

정시: 2023년 5월 8일 ~ 5월 31일
수시1차: 2023년 5월 29일 ~ 6월 20일
수시2차: 2023년 6월 19일 ~ 7월 11일

구비서류는 등기우편 및 직접 제출
우)17058 경기도 용인시 처인구 명지로
116 명지대학교 대학원 교학팀 채민송 앞
- 

전형일

정시: 2023년 6월 9일 ~ 6월 14일
수시1차: 2023년 6월 30일 ~ 7월 5일
수시2차: 2023년 7월 21일 ~ 7월 26일

전형방법: 서류심사 및 면접
전형장소: 추후 공지

- 

합격자 발표

정시: 2023년 6월 27일
수시1차: 2023년 7월 13일
수시2차: 2023년 8월 10일

명지대학교 홈페이지 공지사항 참조
- 

등록기간

추후 통보
본 대학교 지정계좌에 납부

등록금

구 분	중소기업	중견기업
학생	528,500원 이하	906,000원 이하
기업	528,500원	906,000 원
정부지원금	1,963,000원	1,208,000 원
합계	3,020,000원	3,020,000원
비고	정부지원 65%	정부지원 40%

- * **입학금**: 930,000원으로 신입학 시 최초 1회만 납부
- * **장학금**: 성적우수학생 장학금 추가 지원
- * **중견기업**: 매출액 3천억원 미만

교과과목

전공필수과목

전공선택 과목은 학기중 학생 및 기업의 선호도 조사를 통해 개설됩니다.

구 분	교과목	비고
01	반도체 공정 및 장비	전공필수
02	반도체공정장비실습	
03	산학프로젝트 1	
04	산학프로젝트 2	